

证券代码：002008

证券简称：大族激光

大族激光科技产业集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025009

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研	<input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议
	<input type="checkbox"/> 媒体采访	<input type="checkbox"/> 业绩说明会
	<input type="checkbox"/> 新闻发布会	<input type="checkbox"/> 路演活动
	<input checked="" type="checkbox"/> 现场参观	
	<input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）	
参与单位名称 及人员姓名	浙商证券（10月23日）	申量基金（11月12日）
	申万宏源（10月23日）	中信证券策略会（11月12日）
	工银瑞信（10月29日）	财通证券策略会（11月12日）
	金鹰基金（10月29日）	摩根大通（11月14日）
	汇添富基金（10月30日）	花旗银行（11月19日）
	交通银行（10月30日）	平安证券（11月19日）
	兴证全球基金（10月30日）	财通证券（11月19日）
	摩根士丹利（10月31日）	申万宏源策略会（11月20日）
	光大证券（11月3日）	工银安盛（11月20日）
	招商证券策略会（11月4日）	国寿资产（11月21日）
	建信基金（11月4日）	天风证券策略会（11月26日）
	Robeco（11月4日）	财通证券（12月1日）
	贝莱德（11月5日）	国寿养老（12月1日）
	开源证券策略会（11月5日）	Jefferies（12月2日）
	西部证券（11月6日）	工银瑞信（12月3日）
	Jefferies 策略会（11月6日）	华创证券策略会（12月4日）
	摩根资产管理（11月11日）	Point 72（12月4日）
	花旗中国投资者大会（11月11日）	平安资产（12月4日）
时间	2025年10月23日~2025年12月4日	

地点	公司会议室 深圳东海朗廷酒店 深圳丽兹卡尔顿酒店 深圳君悦酒店	深圳福田香格里拉酒店 深圳好日子皇冠假日酒店 上海金茂君悦酒店 北京中国大饭店
上市公司接待人员姓名	管理与决策委员会副主任、董事会秘书 杜永刚 证券事务代表 王琳	
	<p>一、公司经营情况</p> <p>今年以来，随着下游行业需求的逐渐恢复，公司经营情况逐步改善。2025年前三季度实现营业收入 1,271,282.29 万元，营业利润 102,821.90 万元，归属于母公司的净利润 86,337.71 万元，扣除非经常性损益后净利润 56,839.55 万元，分别较上年同期增减 25.51%、-29.72%、-39.46%、51.46%。净利润下降主要由于上年同期公司处置持有的大族思特股权，对归属于上市公司股东的净利润影响约 8.90 亿元；得益于消费类电子市场回暖及叠加 AI 驱动带来的供应链强劲需求，公司信息产业设备市场需求及经营业绩较上年有所增长，故扣除非经常性损益后的净利润随之增长。</p> <p>二、公司 PCB 业务经营及产品情况</p>	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司控股子公司大族数控（股票代码：301200.SZ）2025 年前三季度实现营业收入 390,281.72 万元，较去年同期大幅增长 66.53%，归属上市公司股东的净利润 49,170.68 万元，较去年同期增长 142.19%。2025 年以来，公司紧抓 AI 服务器高多层板需求增长和技术难度提升的双重需求，并进一步增强汽车电子、消费电子多层板及 HDI 板加工设备的竞争力，加上公司应用于高速 PCB、类载板及先进封装领域的新型激光加工方案获得下游客户青睐，公司订单取得显著增长。</p> <p>多层板市场是竞争最为激烈的红海市场，行业强烈需要降本增效的加工方案。公司始终坚持在多层板市场的产品创新，打造各工序协同的大族数控整体加工方案，进一步降低下游客户的综合运营成本，同时为公司产品带来新的增长点。在高多层板市场，随着数据量的急剧增长，AI 服务器、高速交换机需要更高层数、更高密度的高速多层板来承载，为确保高速 PCB 的信号完整性，对孔、线</p>	

路及成品品质提出更高要求。公司相关设备方案不断进行优化，突破 AI 服务器产业链终端客户设计及 PCB 主力厂商生产的技术瓶颈，提供满足 AI 服务器等大厚板日益增加的高厚径比、更严格阻抗公差、更高信号完整性、更高电性能需求的高可靠性加工方案，并在产能和交付方面具有极大的区位优势，助力下游客户快速扩大增长强劲的高多层板市场竞争力，已经取得行业诸多龙头客户的信赖。HDI、先进封装、挠性板等市场领域，公司亦具有创新技术优势，并取得多家龙头客户认证及正式订单。

三、公司消费电子设备业务情况

2025 年前三季度，公司消费电子设备业务营业收入同比有所增长，这一增长源于全球消费电子行业正经历“AI 终端爆发+供应链重构”的双重变革，随着 AI PC、AI 手机、AI 眼镜等终端产品的普及，推动激光加工、3D 打印、自动化检测设备向高精度、多功能集成方向迭代。公司深度参与头部客户前沿研发，为其定制激光钎焊机、密封检测系统等设备，满足 AI 硬件散热结构与微型化需求。消费电子供应链产地已经呈现多元化的发展趋势，境外设备需求呈明显上升趋势，公司紧跟客户步伐，已组建海外生产、研发、销售团队，在东南亚等地承接大客户产能，抢占供应链多元化红利。

四、新能源设备业务情况

2025 年第三季度，公司新能源设备业务营业收入延续上半年增长态势。在全球新能源产业“技术迭代+出海扩张”双周期驱动下，众多行业客户开始启动新一轮扩产投产计划，带动设备需求同步上涨。公司紧跟大客户的扩产步伐，配合大客户的生产节奏，实现销售额显著增长。同时，锂电设备行业的增长重点逐步由国内转向海外，公司在深化大客户国内合作的同时，积极拓展海外市场业务。公司深度绑定宁德时代、中创新航、亿纬锂能等头部客户国内扩产项目，同步配套其海外建设，通过属地化团队规避贸易壁垒，进一步提升动力电池和储能电池装备业务的市场竞争力和市场占有率，并通过加强创新技术研发和精细化管理等多种方式，持续优化盈利结构。

五、公司海外布局发展情况

当前，制造业供应链产地已经呈现多元化的发展趋势，东南亚地区设备需求

	<p>呈明显上升趋势，公司正大力扩充海外研发销售团队人员，紧跟大客户的步伐，抓住供应链多元化带来的市场机会。在 PCB 海外市场方面，由于国际电子终端品牌加速供应链多元化，泰国、越南等东南亚国家 PCB 产业投资项目纷纷投产，预测未来几年的复合成长率将超过中国大陆。随着产业链的重构，美国、欧洲等地区为服务当地半导体产业发展，将全新构建当地的供应体系，其 IC 封装基板未来五年的复合增长率分别高达 18.3% 及 40.6%。</p> <p>六、公司质押情况</p> <p>目前，公司实际控制人及控股股东持有股份质押比例为 73.91%。</p>
附件清单 (如有)	
日期	2025 年 12 月 4 日